

平成29年10月31日

各 位

会社名 日本電産株式会社  
代表者名 代表取締役会長兼社長 永守 重信  
取引所 東証一部(6594)  
問合せ先 広報宣伝部長 生島 志朗  
TEL (075)935-6150

シンガポール プローブカードメーカー SV プローブ社(SV Probe Pte. Ltd.)の  
株式取得完了と新子会社概要

日本電産株式会社(以下、「当社」)の子会社の日本電産リード株式会社(以下、「日本電産リード」)は、平成29年8月21日付「シンガポール プローブカードメーカー SV プローブ社(SV Probe Pte. Ltd.)の株式取得に関する譲渡契約締結のお知らせ」でお知らせしたとおり、平成29年10月31日に、エリプシス社(Ellipsiz Ltd.)の保有するSVプローブ社(SV Probe Pte. Ltd.)の株式100%の取得(以下、「本件取引」)を完了致しました。

買収した会社は当社の子会社となりましたので、その概要についてお知らせ致します。

1. 新子会社概要

(1) 社名	SV Probe Pte. Ltd. ※2018年10月1日よりNidec SV Probe Pte. Ltd.に変更予定
(2) 本社所在地	セラングーン、シンガポール
(3) 代表者	President & CEO Kevin Michael Kurtz
(4) 主な事業内容	プローブカードの製造及び販売
(5) 資本金	29.3百万シンガポールドル
(6) 設立	1994年(2006年よりエリプシス社の完全子会社)
(7) 株主	日本電産リード株式会社 100%
(8) 従業員数	978人(2017年2月時点、連結ベース)
(9) 拠点	シンガポール、台湾、中国、日本、ベトナム、米国
(10) 財務数値	売上高 74.9百万シンガポールドル 営業利益 11.7百万シンガポールドル 営業利益率 15.6% (2017年6月期、連結ベース)

2. 本件取引の目的および今後の運営方針

日本電産リードは、半導体パッケージ基板やプリント基板の通電検査装置および検査用治具の開発・製造・販売を主力事業とし、近年はタッチ・スクリーン・パネル(TSP)の微小容量検査装置や半導体ウェハの光学検査装置にも事業拡大しております。スマートフォンに代表される携帯情報端末やIoT機器に搭載される電子部品は低消費電力化と小型化が求

められ、半導体パッケージ基板においては部品内蔵基板やファンアウト・ウェハ・レベル・パッケージ (FOWLP) <sup>i</sup>など半導体プロセスを応用した工法が採用され、これらの検査に対する顧客ニーズも多様化・高度化しております。

このような中、日本電産リードにおいては半導体プロセスで必要とされる検査技術の確立が中長期の事業成長には不可欠になっており、自社技術の応用開発とともに買収による事業獲得を検討して参りました。

SVプローブ社は半導体検査用プローブカードの製造会社として1994年に米国で設立され、日本やシンガポール、台湾、中国およびベトナムにも拠点を展開しております。

本件買収により日本電産リードは半導体検査用プローブカードの事業を獲得することができ、SVプローブ社は日本電産リードの独自技術であるMEMSスプリング・プローブ<sup>ii</sup>を垂直型プローブカード<sup>iii</sup>に適用することで市場競争力を高めることが見込まれます。また、日本電産リードの検査用治具事業で保有する最先端の加工・組立技術を相互共有し製造面におけるコストダウンや投資効率化を図るとともに、日本電産リードの検査装置をSVプローブ社が持つ営業チャンネルにのせて半導体の有力企業に販売するシナジーも期待されます。

### 3. 今期の業績に与える影響

本件による当期連結業績への影響は軽微ですが、業績予想に与える影響が生じた場合には、詳細が確定次第、証券取引所における適時開示規定に基づき適切に公表します。

以 上

---

i 半導体チップとプリント基板をつなぐ再配線層を半導体工程を用いて半導体チップの外側に拡張して形成するパッケージ。

ii 日本電産リード独自の超微細3次元パターン作成技術(フォトリソグラフィ)によって製造された小径のばね形状を持つ通電検査用接触針。

iii 半導体チップの電気特性を検査するための接触用治具(プローブカード)で、接触針が半導体チップに対して垂直に立てて配列されたもの。